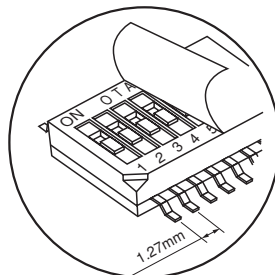


特 長

1. 内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ (P = 1.27mm) の極超小型化を実現。
2. 高密度実装可能 (当社比 8 極にて面積 41.9%)
3. 接点は、金メッキ標準仕様。
4. SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄 (テープシールによる) 可能。  
自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。

主な仕様

定格	DC24V 25mA
接触抵抗	100m Ω 以下
絶縁耐圧	AC300V 1 分間
絶縁抵抗	100M Ω 以上
電氣的寿命	1000 回
使用温度範囲	-30 ~ +85℃
保存温度範囲	-30 ~ +85℃
動作力	4.9N MAX
リフロー回数	2 回



品名の呼称

K

H

S

8

2

E

F

シリーズ名

記号

操作部形状

S

スライドタイプ

記号

極数

22

2

42

4

62

6

82

8

102

10

記号

梱包形態

E

テープリールタイプ

C

マガジンタイプ

記号

テープリール入数

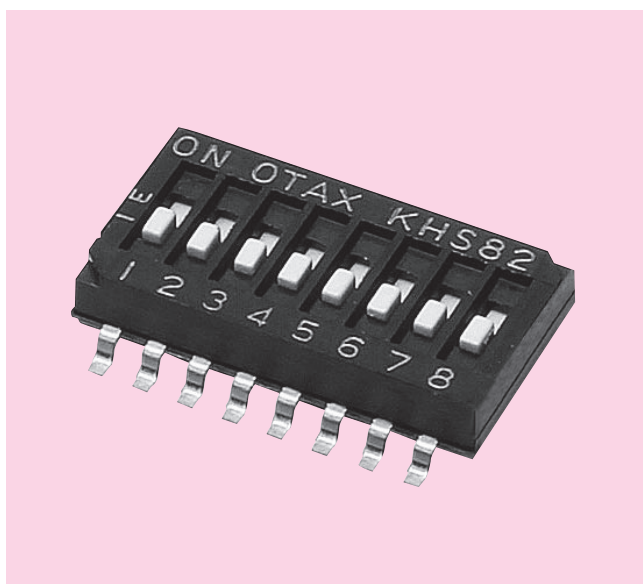
—

2,000 個

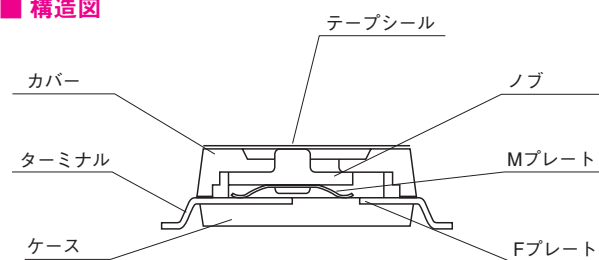
F

500 個

※上記商品以外・カスタム品についてはお問合せください。



## ■ 構造図

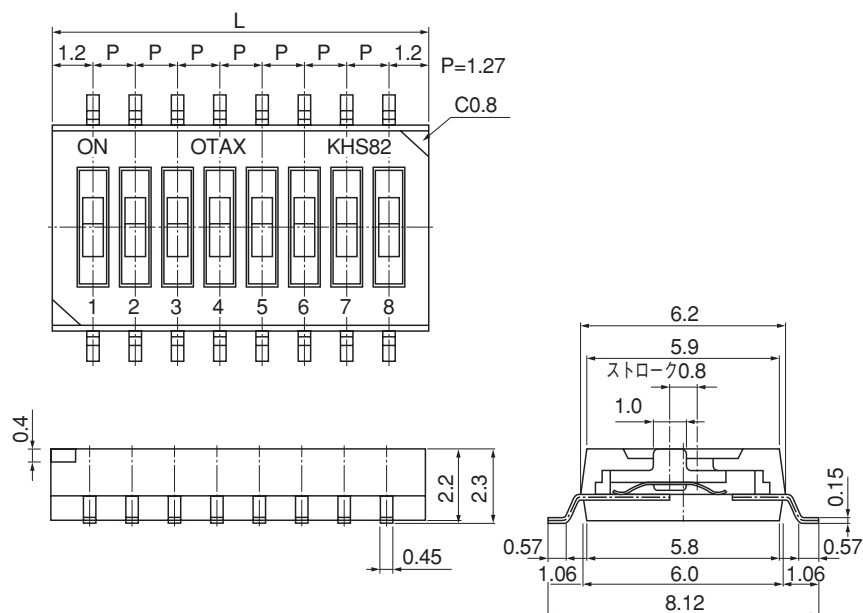


## 材料仕様

部 品 名	材 質	仕 上
カ バ ー	PPS	黒 色
ノ ブ	液晶ポリマー	白 色
ケ ー ス	PPS	黒 色
ターミナル	銅 合 金	金フラッシュ
F プ レ ー ト	銅 合 金	金メッキ
M プ レ ー ト	銅 合 金	金メッキ

## 標準寸法

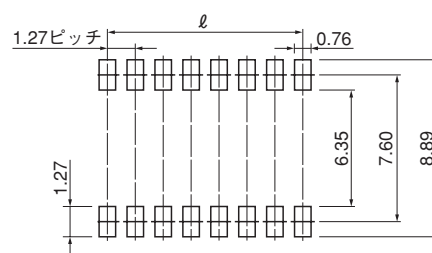
KHS□□



## 品名及び寸法

品 名	極 数	L(mm)	ℓ (mm)
KHS22 □	2	3.67	1.27
KHS42 □	4	6.21	3.81
KHS62 □	6	8.75	6.35
KHS82 □	8	11.29	8.89
KHS102 □	10	13.83	11.43

## 取付ランド寸法

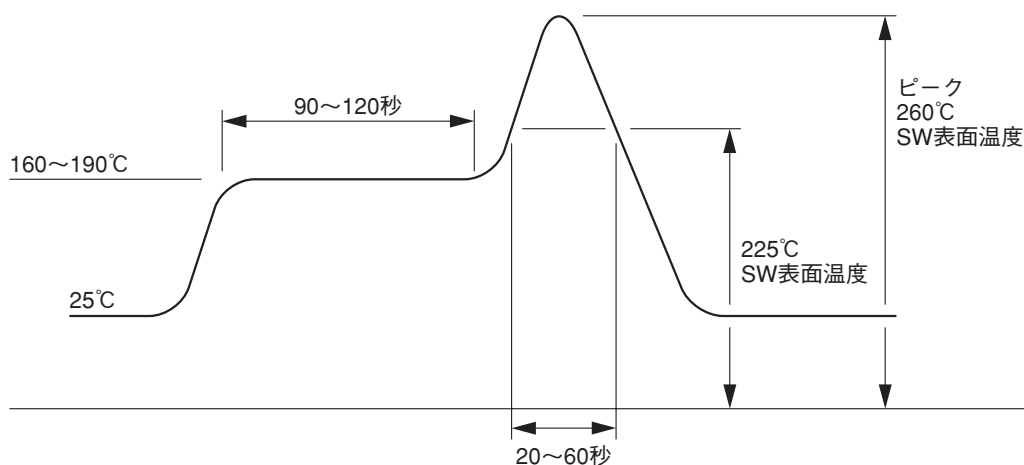


## 半田付について

## ●半田付条件

手半田	コテ先温度 320℃以下 4 ± 1 秒
リフロー半田 (面実装)	プレヒート 160 ～ 190℃ 90 ～ 120 秒 リフロー温度 225℃ 20 ～ 60 秒 ピーク 260℃以下

## ●半田リフロー条件



## 製品取扱上の注意

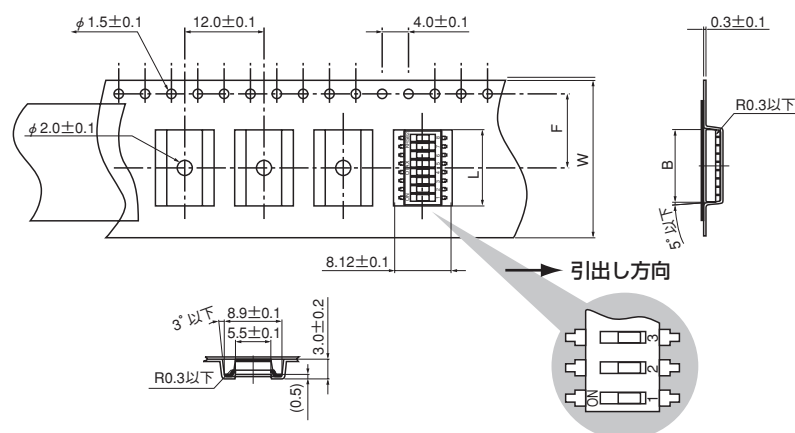
1. 洗浄液は、アルコール類、石油系、ケトン系、塩素系溶剤が使用できます。但し、テルペン系洗浄剤を御使用の場合は、前もってお問い合わせ又は、御確認の上、御使用願います。
2. リフロー半田には実際の作業工程に於いて P/C ボードの寸法、組立密度に依って異なりますので、代理店、又は直接当社にお問合わせ下さい。

## 梱包箱・マガジン梱包数量

極数	マガジン1本 当たりの個数	一箱梱包数量
2	125個	12,500個
4	70個	7,000個
6	50個	5,000個
8	40個	4,000個
10	30個	3,000個

※ 1 箱当たりのマガジン本数は 100 本です。

## テープリールパッケージについて



極数	W	F	B	L
2P	$16.0 \pm 0.3$	$7.5 \pm 0.1$	$4.45 \pm 0.1$	$3.67 \pm 0.5$
4P			$7.0 \pm 0.1$	$6.21 \pm 0.5$
6P			$9.55 \pm 0.1$	$8.75 \pm 0.5$
8P	$24.0 \pm 0.3$	$11.5 \pm 0.1$	$12.1 \pm 0.1$	$11.29 \pm 0.5$
10P			$14.6 \pm 0.1$	$13.83 \pm 0.5$

## 適用規格

JIS C 0806

TB0804 ~ TB2420

EIA-481-A

16,24mm Embossed Tape